

102年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試分試
考試、中醫師、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試、
特種考試聽力師、牙體技術人員考試、102年專門職業及技術
人員高等考試法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試試題

代號：3112
頁次：8-1

等 別：高等考試

類 科：牙體技術師

科 目：牙體技術學(三) (包括全口活動義齒技術學、活動局部義齒技術學科目)

考試時間：1 小時

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

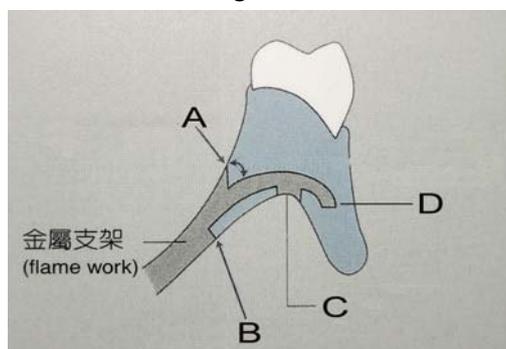
- 閉口運動最主要包括那些肌肉？
(A)咬肌、顳肌、外翼狀肌 (B)咬肌、顳肌、內翼狀肌
(C)顎舌骨肌、二腹肌、外翼狀肌 (D)顎舌骨肌、二腹肌、內翼狀肌
- 拔牙後立即裝戴的義齒，下列何者最正確？
(A)治療用義齒 (B)過渡義齒 (C)完成義齒 (D)即時義齒
- 以下何項義齒基底材質，讓病人裝戴感良好，對生活品質提升有顯著效果，但是作業較為繁雜？
(A)樹脂 (resin) 基底 (B)聚砜 (polysulfone) 基底
(C)聚碳酸鹽 (polycarbonate) 樹脂基底 (D)金屬基底
- 有關全口義齒基底研磨面的敘述，下列何者最正確？
(A)是指所有與軟組織接觸的義齒表面
(B)與義齒的維持、安定無關
(C)外觀必須是外凸的
(D)覆蓋上顎腭部的腭板 (palatal plate) 亦屬於研磨面的一部分
- 全口義齒基底邊緣必須與周圍組織的運作相互協調，因此其形態必須為下列何者？
(A)棒棍狀 (B)刀鋒狀 (C)平板狀 (D)圓筒狀
- 關於全口義齒基底的敘述，下列何者錯誤？
(A)可以採用金屬或樹脂等材料
(B)採用金屬基底時，在義齒唇側研磨面的金屬材料須與周圍組織的運作相互協調
(C)基底黏膜面須與殘嵴黏膜密貼
(D)腭板 (palatal plate) 與吞嚥機能有關
- 有關活動義齒的安定，下列敘述何者最正確？
(A)在靜止狀態下，義齒要從義齒基底下黏膜脫離時，所需力量之抵抗性
(B)在進行咀嚼、吞嚥及發音等機能時，不會發生動搖及脫離
(C)製作高精密度義齒基底是決定因素
(D)在義齒上做邊緣封鎖可達成
- 病患抱怨全口義齒在咬合時義齒會往下陷，以致咬合時有無法施力的感覺，代表下列那項義齒的特性最不足？
(A)維持 (B)安定 (C)支持 (D)美觀
- 若全口義齒在咀嚼時會發生鬆動的現象，以下何項之修正最有可能改善此一問題？
(A)將牙齒排列至較佳位置 (B)延長義齒基底邊緣
(C)將義齒基底之研磨面再磨平滑一些 (D)將義齒基底邊緣縮短
- 拔牙後最少需多久時間才可使新生骨經由反覆添加與吸收，並形成穩定之殘嵴？
(A)6-9 週 (B)3 個月 (C)6 個月 (D)12 個月

- 11 全口義齒製作時，牙醫師與牙技師間工作關連先後順序，下列何者最正確？
(A)咬合基底製作 → 咬合取得 → 咬合器裝戴 → 面弓轉移 (face-bow transfer)
(B)排牙 → 蠟型義齒試戴 → 重新取得咬合記錄 → 包埋、聚合、研磨
(C)精密印模取得 → 咬合基底製作 → 咬合取得 → 咬合器裝戴
(D)排牙 → 蠟型義齒試戴 → 哥德式弓 (Gothic arch) 描記裝置的裝戴 → 咬合記錄取得
- 12 關於在製作全口義齒過程中“咬合取得”步驟的描述，下列何者錯誤？
(A)咬合取得的步驟可能會重複很多次
(B)哥德式弓 (Gothic arch) 描記為咬合取得的方法之一
(C)蠟型義齒試戴時可能再次進行咬合取得步驟
(D)義齒一旦完成就不須再進行咬合取得的步驟
- 13 製作個人牙托時臼齒後墊 (retromolar pad) 部位，最需做下列何種處置？
(A)施壓 (B)緩壓 (relief)
(C)止點器 (stopper) (D)比基底外形線少 2-3 毫米
- 14 製作全口義齒個人牙托時，關於間隙劑 (spacer) 的敘述，下列何者錯誤？
(A)厚度因材料使用不同而不同 (B)一定需要，只是厚度需因狀況不同而調整
(C)須遵照醫師指示製作 (D)使用範圍較緩壓 (relief) 區域大
- 15 下顎第一大臼齒的咬合面大約會與臼齒後墊 (retromolar pad) 的何處在同一高度？
(A)底部 (B)底部 1/3 (C)頂部 1/3 (D)頂點
- 16 在製作全口義齒時，關於咬合蠟堤 (occlusal wax rim) 製作的敘述，下列何者錯誤？
(A)上顎咬合蠟堤其相對於門牙切緣處 (incisal edges)，約會落在門齒乳頭 (incisive papilla) 前緣前方 8-10 毫米
(B)下顎臼齒後墊 (retromolar pad) 的舌側邊緣與小白齒區齒槽骨嵴舌側邊緣的連線為下顎咬合蠟堤舌側的界限
(C)咬合蠟堤在前牙區與後牙區的寬度不必維持一樣寬
(D)咬合蠟堤最好不要用軟性的蠟來製作
- 17 若牙科醫師沒有特別指示，在製作全口義齒之記錄基底 (record base) 與咬合蠟堤 (occlusal wax rim)，當上下顎的蠟堤咬合時，由上下顎犬齒區之記錄基底邊緣量起，其高度最好訂在多少毫米？
(A)20 (B)30 (C)40 (D)50
- 18 製作全口義齒時，關於記錄基底 (record base) 與咬合蠟堤 (occlusal wax rim) 製作的描述，下列何者錯誤？
(A)蠟堤的大小與位置應盡量接近最終排牙的形態與位置
(B)主要模型 (master cast) 上較大的倒凹 (undercut) 應先用石膏封住
(C)基底的製作可用“撒上 (sprinkle-on)”聚合樹脂於模型的方法製作
(D)若空間不足時，記錄基底於排牙時可修磨
- 19 關於全口義齒齒肉形成的敘述，下列何者錯誤？
(A)頰側齒肉形成須在美觀與清潔之間尋求平衡
(B)下顎舌側須凸出以方便舌壓作用而穩定義齒
(C)上顎前牙區的腭部於舌側齒頸部到腭的齒槽部要稍微隆起
(D)臼齒區頰側齒肉不要有極端凹凸
- 20 對 Tench 齒型的描述，下列何者錯誤？
(A)是協助包埋聚合後的義齒可以重新置放回到咬合器的做法
(B)需要破壞模型底座
(C)要小心倒凹 (undercut)
(D)在蠟型義齒試戴完成後進行
- 21 關於義齒包埋 (flasking) 材料的敘述，下列何者錯誤？
(A)使用不同聚合方法的樹脂可用不同的包埋材 (B)熱聚合樹脂可用矽膠類印模材包埋
(C)常溫聚合樹脂可用石膏包埋 (D)瓊膠印模材可用於包埋常溫聚合樹脂

- 22 在進行全口義齒包埋與聚合時，以下何處不能塗樹脂分離劑？
(A)主要工作模 (master cast) (B)包埋工作模的石膏表面
(C)人工牙齒 (D)包埋盒邊緣
- 23 於義齒包埋與聚合時，下列敘述何者錯誤？
(A)加壓法因有油壓機加壓，義齒咬合高度最不會提高
(B)灌入法與加壓法使用不同包埋盒
(C)灌入法較不會造成咬合高度提高
(D)流入法較不會造成咬合高度提高
- 24 使用二階段濕式聚合法聚合加熱聚合樹脂時，第一階段加熱的溫度與時間，下列何者最正確？
(A)65-70°C，60-90 分鐘 (B)55-60°C，60-90 分鐘
(C)100°C，30-60 分鐘 (D)100°C，60-90 分鐘
- 25 全口義齒咬合器再裝戴 (remount) 進行咬合修磨時，下述原則何者錯誤？
(A)在咬合器門齒導柱 (incisal guide pin) 未降回原點前，所有咬合紙的印記都應修磨
(B)對咬合紙印記的部分，每一回都應擦乾淨後才能做下一次的印記
(C)每一次的修磨量要少
(D)修磨應上下顎交互進行
- 26 關於全口義齒於咬合器再裝戴 (remount) 進行咬合修磨時的敘述，下列何者最正確？
(A)中心咬合位與離中心咬合位的選擇性修磨可以交替進行
(B)中心咬合位的選擇性修磨要儘量保存咬窩 (fossa)
(C)離中心咬合位的選擇性修磨主要修磨上顎的頰側咬頭
(D)離中心咬合位的選擇性修磨主要修磨下顎的頰側咬頭
- 27 關於全口義齒於咬合器再裝戴 (remount) 進行咬合「自動磨修」的敘述，下列何者錯誤？
(A)把碳化矽 (carborundum) 粉末與甘油混合當作碳化矽泥來使用
(B)將咬合器門齒導柱 (incisal guide pin) 最後提高的 0.1-0.2 毫米修回到原高度
(C)碳化矽泥的厚度越厚越好
(D)不可施加太大壓力
- 28 義齒研磨的目的不包括以下那項？
(A)增加義齒安定性 (B)減少異物感
(C)減少口內義齒周圍軟組織的受傷 (D)減少牙菌斑附著
- 29 關於全口義齒研磨的敘述，下列何者錯誤？
(A)義齒基底邊緣不可磨得太尖
(B)齒肉形成要避免被破壞
(C)基底黏膜面要使用布輪打亮以免造成黏膜潰瘍
(D)義齒基底邊緣在繫帶部位與其他邊緣部位要一樣厚
- 30 使用研磨馬達 (lathe) 研磨全口義齒時，下列何者最正確？
(A)使用在研磨早期階段 (B)須遠離水氣
(C)應儘量在低轉速下進行 (D)常用在研磨基底黏膜面
- 31 關於義齒研磨的敘述，下列何者錯誤？
(A)去除石膏可以用超音波洗淨器 (B)粗研磨使用砂紙捲磨錐
(C)中研磨使用矽化磨錐 (D)最後研磨可使用研磨馬達裝上磨光刷
- 32 關於義齒研磨的敘述，下列何者錯誤？
(A)義齒基底黏膜面最重要的是尖銳部分的去除
(B)覆蓋在白齒後墊 (retromolar pad) 後緣的義齒基底要儘量薄
(C)研磨完成的義齒成品要浸泡於水中保存
(D)義齒泡在水中有助於去除殘存於基底中的聚合樹脂單體 (monomer)

- 33 有關義齒基底修復，下列敘述何者最正確？
(A)義齒基底樹脂斷裂修復時，使用加熱聚合樹脂，易使樹脂基底產生內部應力
(B)使用金屬線補強時，金屬不做處理直接埋入樹脂內即可
(C)常溫聚合樹脂與加熱聚合樹脂修復相比，二者強度相當
(D)上顎全口義齒容易發生斷裂處是在頰側附近
- 34 下列有關義齒修復的敘述何者最正確？
(A)對於硬樹脂牙咬頭或切緣之破損修復，直接補上複合性樹脂即可
(B)樹脂牙較陶瓷牙易脫落
(C)少數人工牙齒脫落的修復需要印模取得工作模型
(D)因牙技作業不完備造成之破損，大多發生在義齒裝戴後早期
- 35 關於襯底墊 (reline) 的敘述，下列何者錯誤？
(A)直接法之耐久性較好
(B)以直接法進行時，義齒黏膜面需要先磨掉一層舊的樹脂材料
(C)以間接法進行時，基本上就是使用舊義齒當印模托
(D)以間接法進行時，不一定需要使用包埋盒
- 36 以下何者不是金屬基底義齒的優點？
(A)構造強固，不易破損 (B)義齒基底較薄 (C)容易調整 (D)熱傳導好
- 37 關於金屬基底義齒的敘述，下列何者錯誤？
(A)部分樹脂型金屬基底義齒，其基底黏膜面大部分為金屬
(B)部分金屬型金屬基底義齒，其基底黏膜面大部分為樹脂
(C)不可使用貴金屬合金，以免強度不足
(D)金屬基底可使用鑄造法或壓印法製作
- 38 關於金屬鑄造基底製作的描述，下列何者錯誤？
(A)珠緣 (beading) 在上、下顎義齒製作時都須進行
(B)珠緣 (beading) 可防止食物殘渣進到金屬基底下
(C)組織止點 (tissue stop) 可幫助金屬支架正確地置回工作模型上
(D)因義齒接觸而易成為支點的地方，建議緩壓 (relief)
- 39 關於終接線 (finishing line) 的描述，下列何者錯誤？
(A)不適當的外終接線會妨礙義齒的齒肉形成
(B)先試排牙再製作金屬義齒支架，有助於外終接線的定位
(C)適當的終接線可以防止樹脂剝離或斷裂
(D)內外終接線最好在上一位置以便增加樹脂的厚度與強度
- 40 有關天然齒列咬合面所形成的咬合彎曲，下列何者最正確？
(A)上顎白齒咬合面稍微向後外側 (B)下顎白齒咬合面稍微向後外側
(C)前後咬合彎曲，稱 Wilson 彎曲 (D)越是後方的牙齒這種傾斜越不明顯
- 41 影響局部義齒牙鉤 (clasp) 固持力的因素應包括那些？①倒凹的位置 ②倒凹的量 ③鉤臂的長度 ④鉤臂的寬度 ⑤從上臂到下臂的傾斜度 ⑥鉤臂的斷面形態
(A)①②③④⑤⑥ (B)只有②③④⑤⑥ (C)只有①②⑤⑥ (D)只有①②③④
- 42 有關局部義齒 RPI clasp 設計的敘述，下列何者錯誤？
(A)Krol 所設計的 RPI clasp 可以容許局部義齒受咬合壓力發生下沉旋轉
(B)Kratovichil 所設計的 RPI clasp 專為減少局部義齒在機能運動時的動搖
(C)Krol 所設計的 RPI clasp 需要有大一點的導引面，支柱牙牙冠有修復的必要
(D)Kratovichil 所設計的 RPI clasp 近心部位鉤靠面積需要大一點
- 43 有關局部義齒設計的甘迺迪槓 (Kennedy bar)，下列敘述何者錯誤？
(A)為應用連續鉤與舌側槓 (lingual bar) 所組合者
(B)適用於前齒部因牙周疾病而失去近遠心接觸點時
(C)適用於殘留齒有連續性齒間空隙時
(D)與舌側板 (lingual plate) 比較，自淨性良好，不易堆積食物殘渣

- 44 局部義齒舌側鉤靠 (lingual rest) 和切緣鉤靠 (incisal rest) 的比較，下列何者最正確？
 (A) 舌側鉤靠較容易發生旋轉力導致支柱牙產生傾斜
 (B) 切緣鉤靠的荷重方向容易導向齒軸方向
 (C) 切緣鉤靠常需進行支柱牙的牙冠修復得到充分的鉤座
 (D) 舌側鉤靠較容易產生異物感
- 45 有關局部義齒的非緩壓型附連體裝置 (attachment) 的敘述，下列何者最正確？
 (A) 附連體之固定部和活動部為不可動性，咬合壓力對於支柱牙的負擔較大
 (B) 附連體之固定部和活動部為可活動性，咬合壓力對於殘嵴黏膜的負擔較大
 (C) 附連體之固定部和活動部為不可動性，咬合壓力對於殘嵴黏膜的負擔較大
 (D) 附連體之固定部和活動部為可活動性，咬合壓力對於支柱牙的負擔較大
- 46 下列何者不是根面附連體裝置 (attachment) 的優點？
 (A) 不會影響支柱牙周圍的自淨功能，有助牙周健康的維持
 (B) 人工牙齒的排列不受限制，咬合關係和審美性易獲改善
 (C) 著力點低，咬合壓力容易傳導到齒軸方向
 (D) 若失去支柱牙，義齒仍可修理後再度使用
- 47 下列何者不是局部義齒連接體的目的？
 (A) 將局部義齒承受的咬合壓力能傳達到殘嵴和殘留齒
 (B) 減少局部義齒的大小，減輕異物感
 (C) 提供局部義齒固持的能力
 (D) 可以得到局部義齒設計的自由度
- 48 局部義齒在開始人工牙齒排列之前，咬合器上的門齒導柱要如何處置最適當？
 (A) 歸零，與門齒導引檯接觸
 (B) 上舉 1 毫米
 (C) 上舉 3 毫米
 (D) 先移除
- 49 欲設計下顎局部義齒之舌側槓 (lingual bar)，則舌側牙齦緣與口腔底可動黏膜間之距離，至少需要多少毫米？
 (A) 6
 (B) 8
 (C) 10
 (D) 12
- 50 局部義齒小連接體之間間隔距離至少應該有多少毫米？
 (A) 3
 (B) 5
 (C) 7
 (D) 9
- 51 如圖，下列何者為外終接線 (external finishing line) 的位置？



- (A) A
 (B) B
 (C) C
 (D) D
- 52 有關 Spee 彎曲，下列敘述何者最正確？
 (A) 以左右面 (額面) 投影，為連接頰舌側咬頭頂的連線
 (B) 為向下方彎曲的側方性咬合彎曲
 (C) 為在上顎所看到的曲線
 (D) 在矢狀面可以通過下顎頭的前緣

53 如圖，依照 Kammer 的分類是屬於下列那一型？

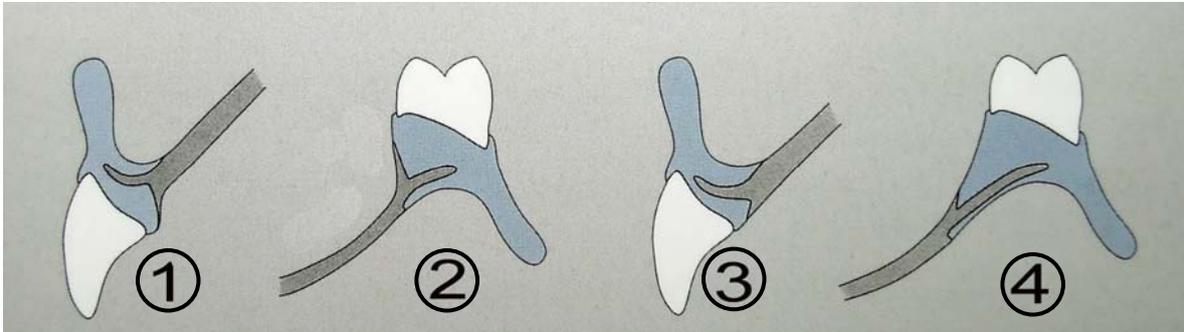


- (A)對角線型 (B)直線型 (C)單側型 (D)多側型

54 依照甘迺迪 (Kennedy) 分類法，若為單側性游離端缺損應屬於下列何者？

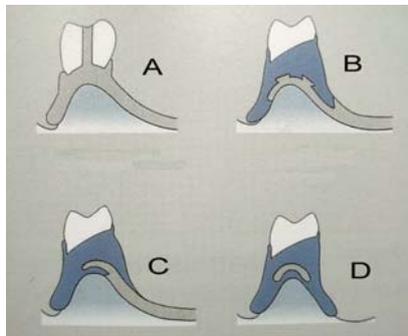
- (A)I 類 (B)II 類 (C)III 類 (D)IV 類

55 如圖，何者是最正確的終接線 (finishing line) 設計？



- (A)①② (B)②③ (C)③④ (D)①④

56 如圖，何者屬於部分樹脂型的金屬基底義齒？



- (A)A (B)B (C)C (D)D

57 從牙鉤 (clasp) 的設計中，那一部位可以提供局部義齒的固持功能？

- (A)鉤肩 (B)鉤尖 (C)鉤靠 (D)鉤腳

58 有關珠緣 (beading) 設計的目的，下列何者錯誤？

- (A)防止食物殘渣侵入大連接體與黏膜之間 (B)改善腭部的舌感
(C)在複製模型上再現大連接體的外形 (D)加強金屬基底的堅固性

59 現今幾乎不再執行換基底 (rebase) 的臨床牙技作業，主要原因之敘述，下列何者錯誤？

- (A)現今襯底墊 (reline) 用樹脂易與義齒基底發生剝落或變色問題
(B)使用陶瓷人工義齒的頻率越來越少
(C)牙技作業太麻煩
(D)義齒必須離開病患一段時間不能使用

60 下列何者不是使用包埋盒 (flask) 包埋法做局部義齒襯底墊 (reline) 的優點？

- (A)襯底墊面平滑不容易污染 (B)殘留的單體 (monomer) 刺激性小
(C)不會造成咬合高度的改變 (D)義齒基底與襯底墊材的交界處不容易剝離

- 61 造成局部義齒基底及人工牙齒破裂破損的原因，應包括下列那些？①義齒基底不合適 ②人工牙齒磨耗引起不適當的咬合 ③義齒基底厚度不足 ④不適切的牙鉤或補強線位置 ⑤緩壓（relief）不足 ⑥義齒在取戴時的疏忽
(A)①②③④⑤⑥ (B)只有①③④⑤⑥ (C)只有②③④⑤⑥ (D)只有③④⑤⑥
- 62 造成局部義齒固位體破損的原因，應包括下列那些？①固位體形態不良 ②義齒基底厚度不足 ③鉤座（rest seat）的形成不完備 ④緩壓（relief）不足 ⑤鑄造時的錯誤 ⑥線鉤彎曲時的重複彎曲
(A)①②③④⑤⑥ (B)只有①③④⑤⑥ (C)只有①③⑤⑥ (D)只有①③⑤
- 63 局部義齒在人工牙齒排列完畢後作選擇性修磨，在離中心咬合位的修磨上若有平衡側的早期接觸存在時，最常是發生在何處？
(A)上顎舌側咬頭外斜面及下顎頰側咬頭內斜面 (B)上顎舌側咬頭內斜面及下顎頰側咬頭內斜面
(C)上顎頰側咬頭外斜面及下顎舌側咬頭內斜面 (D)上顎頰側咬頭內斜面及下顎舌側咬頭外斜面
- 64 有關局部義齒在樹脂聚合完成後之咬合調整，下列順序何者最正確？①形態修正 ②咬合面形成裂溝及溢道 ③咬合嵌合位早期接觸部修磨 ④側方運動及前方運動時的早期接觸部削除
(A)①②③④ (B)①③④② (C)③④①② (D)③④②①
- 65 局部義齒在樹脂聚合完成後之研磨的順序，下列何者最為合理？①使用矽膠磨盤（silicone disc）研磨牙鉤與義齒基底交界處 ②用矽化磨錐（silicone point）研磨義齒基底表面 ③鎢鋼鑽針（tungsten carbide bur）去除殘餘片 ④超音波洗淨器去除研磨材 ⑤石膏溶解液溶解殘存石膏 ⑥磨光刷加磨光材進行磨光
(A)④⑤③①②⑥ (B)⑤②①③④⑥ (C)③⑤①②⑥④ (D)⑤③⑥④②①
- 66 局部義齒樹脂基底加熱聚合時所使用的美國及法國併用式包埋法，下列敘述何者最正確？
(A)人工牙齒包埋在包埋盒的上半部，固位體和連接體包埋在包埋盒下半部
(B)不適用於含槓（bar）及附連體裝置（attachment）的義齒
(C)工作模型與牙鉤（clasp）及槓（bar）的關係容易變動
(D)咬合高度穩定，不容易變動
- 67 舌側槓（lingual bar）的位置最應設計在何處？
(A)上緣離殘留齒牙齦緣 3 毫米，下緣離舌繫帶 3 毫米
(B)上緣離殘留齒牙齦緣 3 毫米，下緣離舌繫帶 1 毫米
(C)上緣離殘留齒牙齦緣 1 毫米，下緣離舌繫帶 3 毫米
(D)上緣離殘留齒牙齦緣 1 毫米，下緣離舌繫帶 1 毫米
- 68 局部義齒在人工牙齒排列完畢後作選擇性修磨，在離中心咬合位的修磨上若有工作側的早期接觸存在時，最應該如何調整？
(A)修磨上顎頰側咬頭內斜面及下顎舌側咬頭內斜面
(B)修磨上顎頰側咬頭內斜面及下顎舌側咬頭外斜面
(C)修磨上顎舌側咬頭外斜面及下顎頰側咬頭外斜面
(D)修磨上顎舌側咬頭外斜面及下顎頰側咬頭內斜面
- 69 有關附連體裝置（attachment）的敘述，下列何者錯誤？
(A)是局部義齒的一種連接體
(B)通常由雄部及雌部兩部分所構成
(C)支柱牙固著的為固位部，在義齒固著的為活動部
(D)藉由機械性結合來取得義齒的維持
- 70 製作局部義齒時，在支柱齒上導引面（guide plane）的高度和寬度的設計，下列何者最正確？
(A)寬度為頰舌側咬頭頂間 1/3 的距離，高度以臨床牙冠的 1/3 為原則
(B)寬度為頰舌側咬頭頂間 1/3 的距離，高度以臨床牙冠的 2/3 為原則
(C)寬度為頰舌側咬頭頂間 2/3 的距離，高度以臨床牙冠的 1/3 為原則
(D)寬度為頰舌側咬頭頂間 2/3 的距離，高度以臨床牙冠的 2/3 為原則

- 71 決定義齒裝脫方向後，析量線（survey line）為印記在殘留齒或殘嵴上何者的連線？
(A)最高點 (B)最深點 (C)最大豐隆部 (D)最大倒凹部
- 72 有關咬合堤的製作，在咬合堤的高度設計上，下列何者錯誤？
(A)前齒部要配合中門齒切緣
(B)臼齒部的中間缺損要與鄰接齒的頰側咬頭高度一致
(C)游離端缺損，在上顎以鉤狀切跡（hamular notch）上 5-7 毫米為基準
(D)游離端缺損，在下顎以臼齒後墊（retromolar pad）高度的 1/2 來製作
- 73 下列何者非個人牙托的特徵？
(A)可以使印模材的厚度相同而得到正確的印模
(B)可以進行肌肉塑形，故能使邊緣形態再現
(C)在缺牙區所設置的間隙劑（spacer）的厚度，可以調整印模時的壓力
(D)為實施修正模型技術時必須使用的工具
- 74 有關牙鉤拮抗臂的敘述，下列何者錯誤？
(A)設置在支柱牙的析量線（survey line）下方
(B)不具維持功能，無法對抗局部義齒的脫離
(C)可對抗局部義齒在裝脫時對支柱牙產生的側向力
(D)鉤尖沒有放置在支柱牙的倒凹區
- 75 下列何者非局部義齒線鉤（wire clasp）的優點？
(A)可以減緩機能運動或義齒裝脫時對支柱牙的負擔
(B)較不容易引起支柱牙的蛀牙
(C)可用於較深的倒凹區，審美性較好
(D)對義齒的動搖和下沉抵抗力好，安定性佳
- 76 有關局部義齒線鉤（wire clasp）鉤臂的設計，下列何者最正確？
(A)鉤臂於析量線的近遠心徑 1/3 附近進入倒凹區，靠近鉤尖 2/3 處在倒凹區
(B)鉤臂於析量線的近遠心徑 1/2 附近進入倒凹區，靠近鉤尖 1/2 處在倒凹區
(C)鉤臂於析量線的近遠心徑 2/3 附近進入倒凹區，靠近鉤尖 1/3 處在倒凹區
(D)鉤臂於析量線的近遠心徑 1/2 附近進入倒凹區，靠近鉤尖 1/3 處在倒凹區
- 77 下列何者不是局部義齒環狀鉤之缺點？
(A)容易引起蛀牙 (B)容易讓支柱牙受到較大的側方壓力
(C)審美性不良 (D)設計時易受支柱牙周圍組織形態的影響
- 78 有關局部義齒反向迴力牙鉤（reverse back action clasp）的設計和使用，下列敘述何者錯誤？
(A)鉤尖使用舌側 far zone 的倒凹區 (B)適用於下顎頰側傾斜的支柱牙
(C)美觀性較差 (D)容易引起食物殘渣的堆積
- 79 有關局部義齒環鉤（ring clasp）的設計，下列敘述何者錯誤？
(A)固位臂鉤尖放置在 near zone 處
(B)大部分用於傾斜之單獨最後大白齒
(C)鉤臂的延伸，上顎通常從頰側，下顎從舌側開始較多
(D)鉤靠一般放在近心和遠心兩處
- 80 假若局部義齒的邊緣必須要與殘留齒接觸時，下列敘述何者錯誤？
(A)在前齒部必須要覆蓋基底結節
(B)在臼齒部要設定在析量線略為下方
(C)齒頸部的牙齦緣要進行封凹（blockout）
(D)必須對病人充分進行牙菌斑控制（plaque control）的指導